CMK

Cu inlay PWB

R&D 銅インレイ配線板

Printed Wiring Board
New Technology

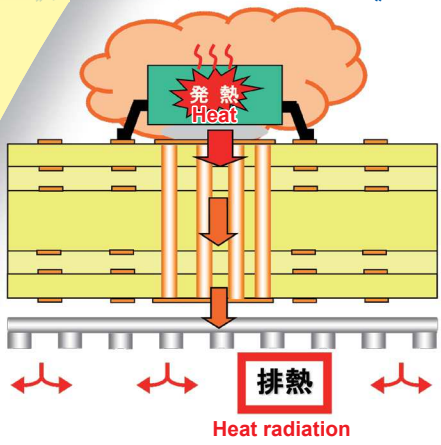
http://www.cmk-corp.com

銅インレイについて About Cu inlay PWB

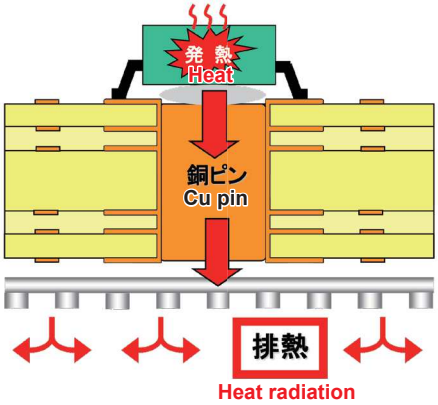
銅インレイとは、発熱部品の直下へ銅ピンを圧入することにより、部分的に排熱特性を向上させる構造

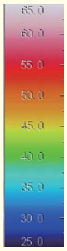
Cu inlay is a structure that enables partial heat radiation by pressing in a Cu pin just under the heating parts

《サーマルビア Thermal VIA》

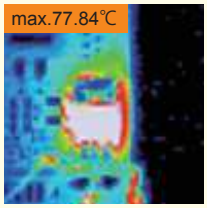


《銅インレイ Cu inlay》

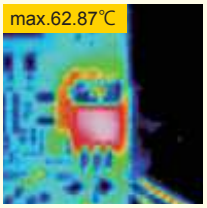




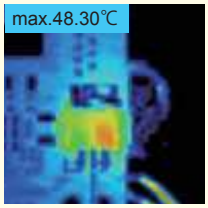
排熱なし
No Heat radiation



サーマルビア
Thermal VIA(42 holes)



銅インレイ
Cu inlay



銅インレイは
従来比-14.57℃
Cu inlay:-14.57℃
compared to conventional PWB

投入電力：20W
Input power:20W

特徴 Feature

- 発熱部品に対して効果的に排熱（板厚方向へダイレクト放熱）
- 排熱のためのコストupと重量upを抑制
- 実績のある配線板構造への適用が可能（従来と同一の設計が可能）
- 同一配線板に制御回路系の混在が可能

- Direct heat radiation to vertical direction
- Control of cost and weight for heat radiation
- Applicable to conventional PCB structure(The same design with conventional PWB is able)
- Coexistance of control circuit and power circuit on one PWB is able

用途 Application

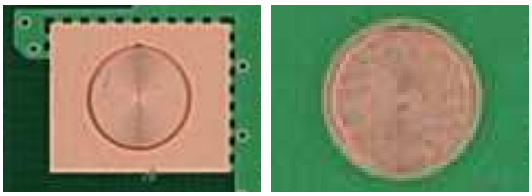
- 局所的な排熱を必要とするパワーデバイス搭載配線板
  （E-ECU向け、DC-DCコンバータ向けなど車載・電源用途）

- Power device PWB that needs partial heat radiation
  (E-ECU use, onboard/ power use as DC-DC converter)

構造 Structure

銅インレイ部断面

銅インレイ部 φ6.0mm（部品面/はんだ面）



Cu inlay part Φ6.0mm
(parts mounting side/ solder side)

基本仕様 Basic specification

板厚 Board thickness	1.2mm～1.6mm
銅ピンサイズ Cu pin size	φ3.0mm～φ6.0mm

記載内容は予告なく変更する場合があります。
2019.06